

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二零年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2020年5月14日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二零年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二零年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.029 億美元，同比下降 8.1%，環比下降 16.4%。
- 毛利率 21.1%，同比下降 11.1 個百分點，環比下降 6.1 個百分點。
- 期內溢利 270 萬美元，上年同期為 4,660 萬美元，上季度為 1,400 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 2,030 萬美元，上年同期為 4,750 萬美元，上季度為 2,620 萬美元。
- 基本每股盈利 0.016 美元，上年同期為 0.037 美元，上季度為 0.020 美元。
- 淨資產收益率（年化）3.6%。

二零二零年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.2 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 22%至 24%之間。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事唐均君先生，對第一季度的業績評論道：

“2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，公司管理層始終把員工的健康安全放在第一位，我們以‘保護好自己、保護好家人、保護好華虹人、保護好華虹’為己任，積極籌措疫情防控物資、採取切實有效的防控措施，保證了員工的身心健康。在落實疫情防控有效措施的同時，我們積極組織原材料和零部件的供應，並通過電話、郵件、微信等方式頻繁與客戶溝通，確保了生產線有序運營，產能利用率一直保持在90%以上，且模擬與電源管理第一季度銷售額同比增長30.6%。由於受到新冠肺炎疫情影響，市場產生了一定的不確定性，公司的嵌入式閃存、分立器件和邏輯及射頻產品需求有了一定程度的放緩，相應產品的出貨量有了不同程度下降。2020年一季度，銷售收入為2.029億美元，同比下降8.1%，環比下降16.4%。毛利率為21%。淨利潤為270萬美元。”

“在新冠肺炎疫情暴發期間，參與項目的建設、工程、研發和管理人員堅守崗位，12英寸生產線項目也穩步推進。”唐先生說道。“受海外疫情影響，參與設備調試的廠商技術人員到崗有所推遲，我們與廠商正協力推進設備的調試工作，相信隨著疫情的好轉，第二階段的工藝設備調試將儘快完成。另外，基於12英寸生產線90nm、65nm研發項目達成了預期目標。”

“我們將繼續做好疫情防控有效措施常態化工作，做到‘四個保護好’。密切與產業鏈互動，確保生產線穩定運營，積極拓展市場，尤其是爭取獲得更多的戰略合作客戶，為公司的可持續發展奠定基礎。感謝我們的團隊辛勤付出！感謝所有股東對我們的支持！”唐先生總結道。

電話會議公告

日期： 二零二零年五月十五日（星期五）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2020 年 5 月 15 日，星期五）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

<https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~firstquarter2020earningsconferencecall> (注：需要注冊才能訪問網絡直播)

電話詳細：	中國大陸	+86 400 624 0406 或 +86 800 870 0531
	中國香港	+852 3018 6768
	中國臺灣	+886 2 7703 1751
	新加坡	+65 6713 5521
	美國	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 5649379

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。(重播密碼: Huahong)

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建有一座 300mm 晶圓廠（華虹七廠），月產能規劃為 4 萬片。華虹七廠於 2019 年正式落成並邁入生產運營期，成為中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，也是大陸第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	202,854	220,753	242,784	(8.1)%	(16.4)%
銷售成本	(160,132)	(149,756)	(176,755)	6.9 %	(9.4)%
毛利	42,722	70,997	66,029	(39.8)%	(35.3)%
毛利率	21.1 %	32.2 %	27.2 %	(11.1)	(6.1)
經營開支	(71,462)	(31,727)	(71,361)	125.2 %	0.1 %
其他收入淨額	20,043	5,457	24,145	267.3 %	(17.0)%
稅前溢利	(8,697)	44,727	18,813	(119.4)%	(146.2)%
所得稅收益/(開支)	11,442	1,914	(4,785)	497.8 %	(339.1)%
期內溢利	2,745	46,641	14,028	(94.1)%	(80.4)%
淨利潤率	1.4 %	21.1 %	5.8 %	(19.7)	(4.4)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	20,314	47,466	26,186	(57.2)%	(22.4)%
非控股權益	(17,569)	(825)	(12,158)	2029.6 %	44.5 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.016	0.037	0.020	(56.8)%	(20.0)%
攤薄	0.016	0.037	0.020	(56.8)%	(20.0)%
付運晶圓(折合 8 吋吋片)	463	446	515	3.8 %	(10.1)%
產能利用率 ¹	82.4 %	87.3 %	88.0 %	(4.9)	(5.6)
淨資產收益率 ²	3.6 %	8.8 %	4.8 %	(5.2)	(1.2)

二零二零年第一季度

- 銷售收入 2.029 億美元，同比下降 8.1%，主要由於平均售價下降；環比下降 16.4%，主要由於晶圓銷售量下降以及平均售價下降。
- 銷售成本 1.601 億美元，同比上升 6.9%，主要由於晶圓銷售量增加和折舊成本上升；環比下降 9.4%，主要由於晶圓銷售量下降以及上季度計提年終獎金。
- 毛利率 21.1%，同比下降 11.1 個百分點，主要由於平均售價下降，折舊費用上升及產品組合變化；環比下降 6.1 個百分點，主要由於平均售價下降及產品組合變化。
- 經營開支 7,150 萬美元，同比上升 125.2%，主要由於無錫工廠的人員開支、研發工程片開支及折舊費用的上升所致，環比基本持平。
- 其他收入淨額 2,000 萬美元，同比上升 267.3%，主要受益於(i)本季度取得匯兌收益，上年同期為匯兌損失，(ii)政府補貼增加；環比下降 17.0%，主要由於(i)分占一家聯營公司溢利減少，及(ii)政府補貼減少，部分被本期匯兌收益上期為匯兌損失的變動影響所抵消。
- 所得稅收益 1,140 萬美元，上年同期為 190 萬美元，主要由於轉回上年度計提的股利代扣代繳稅金增加。
- 期內溢利 270 萬美元，上年同期為 4,660 萬美元，上季度為 1,400 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 2,030 萬美元，上年同期為 4,750 萬美元，上季度為 2,620 萬美元。
- 基本每股盈利 0.016 美元，上年同期為 0.037 美元，上季度為 0.020 美元。
- 淨資產收益率(年化) 3.6%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	200,572	220,753	235,370	(9.1)%	(14.8)%
毛利	42,320	70,997	66,427	(40.4)%	(36.3)%
毛利率	21.1 %	32.2 %	28.2 %	(11.1)	(7.1)
經營開支	(29,098)	(26,825)	(37,997)	8.5 %	(23.4)%
稅前溢利	27,157	47,065	43,625	(42.3)%	(37.7)%
稅息折舊及攤銷前利潤	71,478	77,914	76,446	(8.3)%	(6.5)%
稅息折舊及攤銷前利潤率	35.6 %	35.3 %	32.5 %	0.3	3.1
付運晶圓(8吋仟片)	460	446	506	3.1 %	(9.1)%
華虹無錫					
銷售收入	2,282	-	7,414	N/A	(69.2)%
毛利	402	-	(398)	N/A	(201.0)%
毛利率	17.6 %	N/A	(5.4)%	N/A	23.0
經營開支	(42,364)	(4,902)	(33,364)	764.2 %	27.0 %
稅前溢利	(35,854)	(2,338)	(24,812)	1433.5 %	44.5 %
稅息折舊及攤銷前利潤	(22,800)	(2,338)	(17,555)	875.2 %	29.9 %
稅息折舊及攤銷前利潤率	(999.1)%	N/A	(236.8)%	N/A	(762.3)
付運晶圓(折合8吋仟片)	3	N/A	9	N/A	(66.7)%

華虹 8 吋

- 銷售收入 2.006 億美元，同比下降 9.1%，主要由於平均售價下降；環比下降 14.8%，主要由於晶圓銷售量和平均售價下降。
- 毛利率 21.1%，同比下降 11.1 個百分點，主要由於平均售價下降，折舊成本上升以及產品組合變化；環比下降 7.1 個百分點，主要由於平均售價下降以及產品組合變化。
- 經營開支 2,910 萬美元，同比上升 8.5%，主要由於人員費用和研發費用上升所致；環比下降 23.4%，主要由於上季度計提年終獎金和設備減值準備所致。
- 稅前溢利 2,720 萬美元，上年同期為 4,710 萬美元，上季度為 4,360 萬美元。

華虹無錫

- 銷售收入 230 萬美元。
- 經營開支 4,240 萬美元，上年同期為 490 萬美元，上季度為 3,340 萬美元，主要由於研發費用及折舊費用的上升所致。
- 稅前虧損為 3,590 萬美元。
- 稅息折舊及攤銷前虧損 2,280 萬美元。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	195,816	96.5%	215,146	97.5%	(19,330)	(9.0)%
其他	7,038	3.5%	5,607	2.5%	1,431	25.5 %
銷售收入總額	202,854	100.0%	220,753	100.0%	(17,899)	(8.1)%

- 本季度 96.5% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按分部劃分的 銷售收入	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
華虹 8 吋	200,572	98.9%	220,753	100.0%	(20,181)	(9.1)%
華虹無錫	2,282	1.1%	-	-	2,282	N/A
銷售收入總額	202,854	100.0%	220,753	100.0%	(17,899)	(8.1)%

- 本季度來自於華虹 8 吋和華虹無錫的銷售收入分別為 2.006 億美元及 230 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	124,535	61.4%	116,569	52.8%	7,966	6.8 %
亞洲 ⁴	29,306	14.4%	25,018	11.3%	4,288	17.1 %
美國	25,363	12.5%	41,094	18.6%	(15,731)	(38.3)%
歐洲	16,209	8.0%	18,460	8.4%	(2,251)	(12.2)%
日本 ⁵	7,441	3.7%	19,612	8.9%	(12,171)	(62.1)%
銷售收入總額	202,854	100.0%	220,753	100.0%	(17,899)	(8.1)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.245 億美元，占銷售收入總額的 61.4%，同比增長 6.8%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,930 萬美元，同比增長 17.1%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 2,540 萬美元，同比減少 38.3%，主要由於通用 MOSFET、超級結、邏輯及 MCU 產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,620 萬美元，同比減少 12.2%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 740 萬美元，同比減少 62.1%，主要由於邏輯、MCU 及超級結產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	73,360	36.2%	84,668	38.4%	(11,308)	(13.4)%
分立器件	75,767	37.3%	83,821	37.9%	(8,054)	(9.6)%
模擬與電源管理	31,005	15.3%	23,741	10.8%	7,264	30.6 %
邏輯及射頻	19,685	9.7%	24,360	11.0%	(4,675)	(19.2)%
獨立非易失性存儲器	2,848	1.4%	4,024	1.8%	(1,176)	(29.2)%
其他	189	0.1%	139	0.1%	50	36.0 %
銷售收入總額	202,854	100.0%	220,753	100.0%	(17,899)	(8.1)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 7,340 萬美元，同比減少 13.4%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 7,580 萬美元，同比減少 9.6%，主要由於超級結產品的需求減少。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,100 萬美元，同比增長 30.6%，主要得益於模擬、其他電源管理及 LED 照明產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 1,970 萬美元，同比減少 19.2%，主要由於邏輯產品的需求減少。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 280 萬美元，同比減少 29.2%，主要由於閃存產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 μ m 及以下	66,758	32.9%	84,240	38.2%	(17,482)	(20.8)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	31,965	15.8%	25,694	11.6%	6,271	24.4 %
0.25 μ m	3,365	1.7%	2,472	1.1%	893	36.1 %
0.35 μ m 及以上	100,766	49.6%	108,347	49.1%	(7,581)	(7.0)%
銷售收入總額	202,854	100.0%	220,753	100.0%	(17,899)	(8.1)%

- 本季度 0.13 μ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 6,680 萬美元，同比減少 20.8%，主要由於智能卡芯片和邏輯產品的需求減少。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,200 萬美元，同比增長 24.4%，主要得益於 MCU 和模擬產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 340 萬美元，同比增長 36.1%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.008 億美元，同比減少 7.0%，主要由於超級結產品的需求減少。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	125,393	61.8%	135,536	61.4%	(10,143)	(7.5)%
工業及汽車	50,088	24.7%	44,774	20.3%	5,314	11.9 %
通訊	18,638	9.2%	30,131	13.6%	(11,493)	(38.1)%
計算機	8,735	4.3%	10,312	4.7%	(1,577)	(15.3)%
銷售收入總額	202,854	100.0%	220,753	100.0%	(17,899)	(8.1)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.254 億美元，占銷售收入總額的 61.8%，同比減少 7.5%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 5,010 萬美元，同比增長 11.9%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 1,860 萬美元，同比減少 38.1%，主要由於邏輯、智能卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 870 萬美元，同比減少 15.3%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	50	53
7 號晶圓廠 (300mm)	10	-	10
合計折合 8 吋產能	201	175	201
產能利用率 (200mm)	91.9%	87.3%	92.5%
產能利用率 (300mm)	6.9%	-	31.6%
總體產能利用率	82.4%	87.3%	88.0%

- 本季度末月產能達 201,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 82.4%。

付運晶圓

折合 8 吋仟片晶圓	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	463	446	515	3.8 %	(10.1)%

- 本季度付運晶圓 463,000 片，同比增加 3.8%，環比減少 10.1%。

經營開支分析

以千美元計	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,301	2,025	2,899	13.6 %	(20.6)%
管理費用 ⁷	69,161	29,702	68,462	132.8 %	1.0 %
經營開支	71,462	31,727	71,361	125.2 %	0.1 %

- 經營開支 7,150 萬美元，同比上升 125.2%，主要由於無錫工廠的人員開支、研發工程片開支及折舊費用的上升所致，環比基本持平。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

⁷ 管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

其他收入淨額

以千美元計	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,098	3,184	3,091	(2.7)%	0.2 %
利息收入	2,710	5,638	2,898	(51.9)%	(6.5)%
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	3,454	5,873	4,776	(41.2)%	(27.7)%
匯兌收益/(損失)	1,352	(9,691)	(2,185)	(114.0)%	(161.9)%
分佔一家聯營公司溢利	2,896	383	6,401	656.1 %	(54.8)%
財務費用	(317)	(316)	(324)	0.3 %	(2.2)%
政府補貼	6,607	229	9,098	2785.2 %	(27.4)%
其他	243	157	390	54.8 %	(37.7)%
其他收入淨額	20,043	5,457	24,145	267.3 %	(17.0)%

- 其他收入淨額 2,000 萬美元，同比上升 267.3%，主要受益於(i)本季度取得匯兌收益，上年同期為匯兌損失，(ii)政府補貼增加；環比下降 17.0%，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利減少，及(ii)政府補貼減少，部分被本期匯兌收益上期為匯兌損失的變動影響所抵消。

現金流量分析

以千美元計	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所(用)/得現金流量淨額	(6,639)	78,859	(7,269)	(108.4)%	(8.7)%
投資活動所得/(用)現金流量淨額	51,368	(24,124)	4,040	(312.9)%	1171.5 %
融資活動所得/(用)現金流量淨額	1,662	317,684	(1,642)	(99.5)%	(201.2)%
外匯匯率變動影響淨額	(4,375)	5,840	6,487	(174.9)%	(167.4)%
現金及現金等價物變動影響淨額	42,016	378,259	1,616	(88.9)%	2500.0 %

- 本季度經營活動所用現金流量淨額 660 萬美元，上年同期為經營所得現金流量淨額 7,890 萬美元，主要由於本季度貿易收款減少，及供應商付款和員工開支增加。
- 投資活動所得現金流量淨額 5,140 萬美元，其中(i)贖回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 2.488 億美元，(ii) 利息收入 320 萬美元；部分被(i)設備及無形資產投資支出 2.006 億美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 170 萬美元，其中發行股份收到款項 380 萬美元；部分被(i) 租賃負債支出 200 萬美元，及(ii)支付利息 10 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)
資產總額	3,540,298	3,613,303
負債總額	498,079	530,711
所有者權益總額	3,042,219	3,082,592
資產負債率 ⁸	14.1%	14.7%

資本開支

以千美元計	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	31,409	32,890
華虹無錫	169,141	96,315
合計	200,550	129,205

- 本季度資本開支 2.006 億美元，其中 1.691 億美元用於華虹無錫。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)
存貨	154,736	142,087
貿易應收款項及應收票據	156,223	164,968
預付款項、按金及其他應收款項	133,057	113,453
應收關聯方款項	10,593	9,262
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	270,167	519,779
已凍結存款及定期存款	70,765	70,776
現金及現金等價物	518,302	476,286
流動資產總額	1,313,843	1,496,611
貿易應付款項	95,510	86,119
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	268,710	303,614
計息銀行借款	4,234	4,300
租賃負債	2,977	1,922
政府補助	40,017	40,641
應付關聯方款項	16,531	10,655
應付所得稅	31,431	28,088
流動負債總額	459,410	475,339
淨營運資金	854,433	1,021,272
速動比率	2.5x	2.8x
流動比率	2.9x	3.1x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	73	58
存貨周轉天數	83	70

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1.135 億美元上升至本季度末的 1.331 億美元，主要由於待抵扣進項稅的增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 930 萬美元上升至本季度末的 1,060 萬美元，主要由於一家關聯客戶的貿易應收款增加。
- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產由上季度末的 5.198 億美元下降至本季度末的 2.702 億美元，主要由於理財產品的贖回。
- 貿易應付款項由上季度末的 8,610 萬美元上升至本季度末的 9,550 萬美元，主要由於無錫工廠原物料及備品備件採購增加。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 3.036 億美元下降至本季度末的 2.687 億美元，主要由於本季度支付年終獎金及資本性開支。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,070 萬美元上升至本季度末的 1,650 萬美元，主要由於收到關聯方的預付租金款。
- 應付所得稅由上季度末的 2,810 萬美元上升至本季度末的 3,140 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 8.544 億美元，流動比率 2.9。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 73 天。
- 本季度末存貨周轉天數 83 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)
銷售收入	202,854	220,753	242,784
銷售成本	(160,132)	(149,756)	(176,755)
毛利	42,722	70,997	66,029
其他收入及收益	17,464	15,093	20,090
投資物業的公平值收益	-	-	163
銷售及分銷費用	(2,301)	(2,025)	(2,899)
管理費用	(69,161)	(29,702)	(68,462)
其他費用	-	(9,703)	(2,185)
財務費用	(317)	(316)	(324)
分佔一家聯營公司溢利	2,896	383	6,401
稅前溢利	(8,697)	44,727	18,813
所得稅收益/(開支)	11,442	1,914	(4,785)
期內溢利	2,745	46,641	14,028
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	20,314	47,466	26,186
非控股權益	(17,569)	(825)	(12,158)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.016	0.037	0.020
攤薄	0.016	0.037	0.020
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,290,612,948	1,284,456,115	1,287,054,838
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,303,317,948	1,298,603,115	1,296,177,838

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (已審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	1,659,799	1,558,283	853,827
使用權資產	74,809	74,526	77,640
投資物業	166,023	168,615	174,523
無形資產	10,766	13,322	10,087
於聯營公司的投資	74,898	73,142	65,620
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	204,497	207,689	212,370
長期預付款項	14,721	6,740	23,658
應收關聯方款項	13,629	6,808	7,053
遞延稅項資產	7,313	7,567	6,983
非流動資產總額	2,226,455	2,116,692	1,431,761
流動資產			
存貨	154,736	142,087	140,322
貿易應收款項及應收票據	156,223	164,968	160,012
預付款項、按金及其他應收款項	133,057	113,453	20,360
應收關聯方款項	10,593	9,262	6,789
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	270,167	519,779	606,094
已凍結存款及定期存款	70,765	70,776	796
現金及現金等價物	518,302	476,286	1,155,259
流動資產總額	1,313,843	1,496,611	2,089,632
流動負債			
貿易應付款項	95,510	86,119	74,880
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	268,710	303,614	151,363
計息銀行借款	4,234	4,300	4,455
租賃負債	2,977	1,922	1,393
政府補助	40,017	40,641	59,810
應付關聯方款項	16,531	10,655	17,697
應付所得稅	31,431	28,088	37,699
流動負債總額	459,410	475,339	347,297
流動資產淨額	854,433	1,021,272	1,742,335
總資產減流動負債	3,080,888	3,137,964	3,174,096
非流動負債			
計息銀行借款	21,171	21,502	26,732
租賃負債	15,837	16,694	16,926
遞延稅項負債	1,661	17,176	9,362
非流動負債總額	38,669	55,372	53,020
淨資產	3,042,219	3,082,592	3,121,076
權益和負債權益			
股本	1,968,961	1,966,095	1,960,929
儲備	265,907	279,146	285,854
本公司擁有人應佔權益	2,234,868	2,245,241	2,246,783
非控股權益	807,351	837,351	874,293
權益總額	3,042,219	3,082,592	3,121,076

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日	於三月三十一日	於十二月三十一日
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
經營活動所(用)/得現金流量：			
稅前溢利	(8,697)	44,727	18,814
折舊及攤銷	45,616	30,533	39,754
應佔聯營公司溢利	(2,896)	(383)	(6,401)
營運資金的變動及其它	(40,662)	3,982	(59,436)
經營活動所(用)/得現金流量淨額	(6,639)	78,859	(7,269)
投資活動所得/(用)現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(200,550)	(110,217)	(129,206)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	-	-	94,519
其他投資活動所得現金流量	251,918	86,093	38,727
投資活動所得/(用)現金流量	51,368	(24,124)	4,040
融資活動所得/(用)現金流量：			
非控股權益出資	-	317,000	-
發行股份所得收益	3,817	779	1,204
償還銀行貸款	-	-	(2,150)
償還租賃負債	(2,078)	-	(612)
已付利息	(77)	(95)	(84)
融資活動所得/(用)現金流量	1,662	317,684	(1,642)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	46,391	372,419	(4,871)
外匯匯率變動影響淨額	(4,375)	5,840	6,487
期初現金及現金等價物	476,286	777,000	474,670
期末現金及現金等價物	518,302	1,155,259	476,286

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
唐均君(總裁)

非執行董事

杜洋
森田隆之
王靖
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司
張素心
董事長兼執行董事

中國 香港
二零二零年五月十四日